

ポータルサイトを通じた 中小金型メーカーとの連携で 半導体封止金型をはじめとする 新市場を掘り起こす

CAPABLE

半導体封止金型のファブレスメーカーである(株)CAPABLE（ケイパブル、京都市南区）が、新たなモノづくりポータルサイトの運営を本格的にスタートする。ポータルサイトを通じて国内外の市場で得た金型需要を国内の金型メーカーに紹介することで、金型メーカーの機械稼働率の向上や技術力アップに貢献する。製造業の海外移転や新型コロナウイルス感染症拡大の影響で、金型メーカーへの逆風が強まる中、ポータルサイトに参加するパートナー企業との連携を強めながら、「日本の金型産業の復活」を目指す方針だ。

同社の創業は2012年。丸紅で半導体製造装置関連の業務に長年携わり、半導体封止装置とそれに付随する半導体封止金型で国際的に高いシェアをもつ



図1
河原洋逸社長

TOWAの社長も務めた河原洋逸氏（図1）が立ち上げたベンチャー企業である。

中小メーカーの声に後押しされて

60歳でTOWA社長を退いた2011年頃、河原氏は知り合いのコンサルティング会社に頼まれて、金型製造や金属加工業を営む中小・零細企業向けの経営セミナーの講師を務めていた。そこで大手メーカーの海外生産移転で苦境に立たされた中小・零細メーカーの実態を聞かされる。「初回は30人くらい来てくれたセミナーの参加者が、回を重ねるごとに減っていきました。『あんなに熱心だったのに、〇〇の社長さんはどうしたの?』と尋ねると、『お客さんの海外移転で仕事が減って廃業しました』、『金策に走り回っているそうです』などと聞かされた。皆さんから、『TOWAの社長まで務めたなら仕事を紹介してほしい』と言われ、何かできないかと考えました」（河原社長）。

折しも、TOWA時代に付き合いのあった台湾や韓国のOSAT（オーサット：半導体のパッケージングを請け負うメーカー）からは、「日本の優秀な金型メーカーの金型を使いたい」という声を聞いていた。OSATはTOWAやアピックヤマダなどの半導体製造装置メーカーから装置と金型をセットで購入するが、仕様が標準化されてつくりだめができる装置に対し、個別仕様が決まってから設計をスタートする金型は、主に内製していることから生産キャパシティをオーバーする繁忙期には長納期が常態化し、必要な数量がすぐに納入されず、OSAT側の課題となっていた。

半導体には「シリコンサイクル」と呼ばれる需要の波があり、半導体製造装置メーカー各社は需要の少ない時期に製造キャパシティを合わせるのが一般的だ。そのため需要のピークには装置と一部の金型を先に納入し、残りの金型は順次納入するという形をとらざるを得ない。半導体は新製品が発売されてから時間が経